

集積化 MEMS の発展と展望

集積化 MEMS 技術研究会発足 10 周年記念シンポジウム

3 月 18 日 (日)

13:00 ~ 18:30

早稲田大学 西早稲田キャンパス
63 号館 201 (G201)

MEMS技術とLSI技術との集積化・融合は重要な課題であり、More than Moore の解の一つとして期待され、世界的潮流として研究開発が活発化してきた。

シンポジウムでは研究会と集積化 MEMS 技術 10 年のあゆみを検証すると共に、今後の展望について情報交換する。

基調講演 (13:00~15:15)

石田 誠 豊橋技術科学大学 特別顧問, 名誉教授
「集積化 MEMS 技術研究会」の発足と異分野融合研究



石田 誠



益 一哉

益 一哉 東京工業大学 教授
応物と集積化 MEMS 技術研究会

福田 和人 東日本旅客鉄道株式会社
鉄道信号技術の現在と未来: デバイスへの期待



福田 和人



小松崎 常夫

小松崎 常夫 セコム株式会社 顧問
セコムが目指す「あんしんプラットフォーム」とデバイス技術への期待

招待講演 (15:30~18:30)

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 町田 克之、益 一哉 (東京工業大学) | 集積化 CMOS-MEMS 技術の課題と展望 |
| 年吉 洋 (東京大学) | 薄膜トランジスタを用いた集積化 MEMS |
| 田中 秀治 (東北大学) | 接合による集積化 MEMS プロセス |
| 前中 一介 (兵庫県立大学) | 集積化センサ、コンボセンサ IoT センサノードへ |
| 高尾 英邦 (香川大学) | シリコン集積化 MEMS 技術による高解像度触覚センシング |
| 後藤 正英 (NHK放送技術研究所) | 3次元集積化技術を用いた次世代イメージセンサの研究開発 |
| 積 知範 (オムロン株式会社) | 環境センサ技術の応用 |
| 森村 浩季 (日本電信電話株式会社) | LSI 回路設計の立場から見た集積化 MEMS 技術への期待 |
| 高橋 一浩 (豊橋技術科学大学) | 集積化 MEMS 技術によるバイオセンシング |
| 佐々木 実 (豊田工業大学) | MEMS 振動子を用いた絶縁型電圧センサ |
| 鈴木 健一郎 (立命館大学) | MEMS マイクロエレクトロニクス半世紀の流れー私的追想ー |

JSAP EXPO Spring 2018

MEMS特別展示コーナー開催

2018年3月17日(土)~20日(火)

@ベルサール高田馬場 (東京都新宿区)

